



NESPER

Fortschritt formen.



Contact Pads

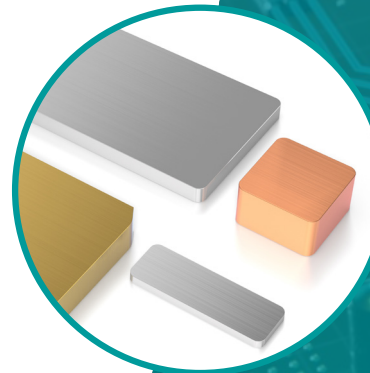
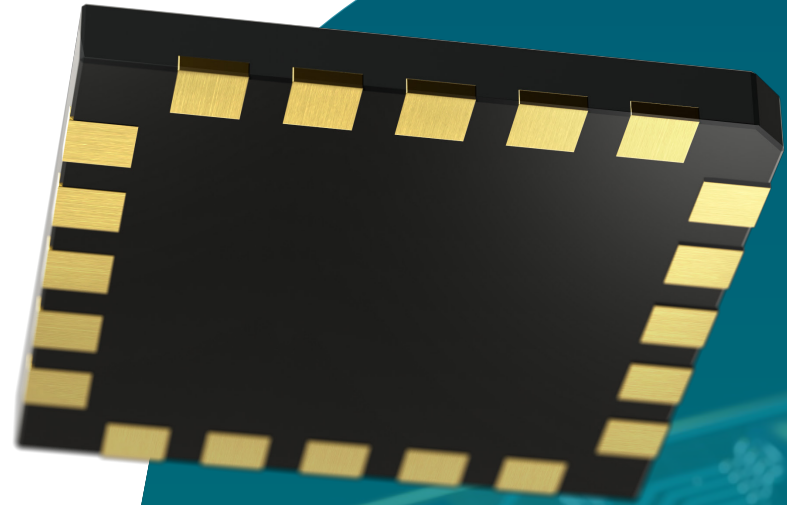
PRÄZISION IN PERFEKTION

[MEHR INFORMATIONEN](#)

Einsatzbereiche

Unsere Contact Pads überzeugen in verschiedenen Einsatzbereichen:

- > Cooling Pads / Heatsinks
- > Sinter Pads
- > Soldering Pads
- > Bond Pads
- > Kontaktierung von Chips, MOSFETs & PowerFETs
- > Chip Packaging: Land Grid Pads (LGA)
- > Spacer Elemente
- > Bestückung von Leiterplatten (PCB)



Technische Möglichkeiten & Spezifikationen

Gefertigt nach Ihren Anforderungen.

In verschiedensten Ausführungen, Materialien und Beschichtungen:

- > **Kantenlängen von 0,2 bis 5 mm**
- > **Extrem geringe Toleranzen**,
z. B. Ebenheit < 10 µm – für große Kontaktflächen und langlebige,
zuverlässige Kontaktierungen
- > **Kupfer- und Stahllegierungen**,
u. a. Cu-Legierungen und FeNi42
- > **Galvanische Beschichtungen**
wie Silber (Ag), Gold (Au) oder Nickel (Ni)
- > **Flexible Verpackungsoptionen:**
Schüttgut, Tape & Reel u. a.

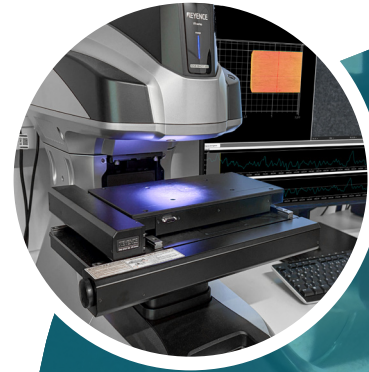


Innovativer Herstellungsprozess

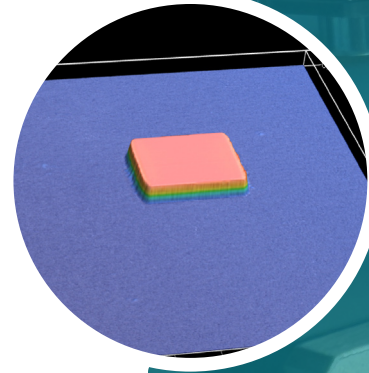
Bei NESPER ist Innovation mehr als nur ein Schlagwort.

Unser Fokus auf intelligente Automatisierung und moderne Produktionsprozesse setzt Maßstäbe in Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit:

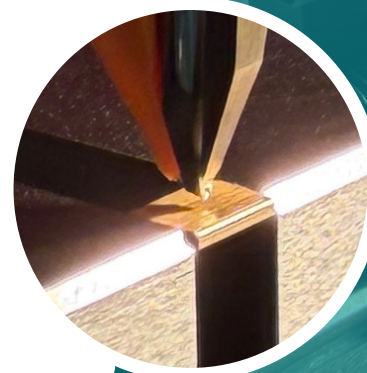
- **Kontinuierliche Investitionen in zukunftsweisende Ideen**, neue Technologien und intelligentere Prozesse – für höchste Prozessstabilität und gleichbleibende Qualität.
- Nutzung von **High-Tech-Fertigung und Engineering-Know-how** für fortschrittliche Designanalysen und Materialoptimierung, um Ausschuss zu minimieren und den Materialertrag zu maximieren.
- **Keine Nachbearbeitung notwendig**
kein Schleifen, kein Läppen
- Lieferung **kompromissloser Qualität im großen Maßstab**, indem komplexe Produktionsherausforderungen in effiziente, wiederholbare Exzellenz überführt werden.
- **Attraktive, international wettbewerbsfähige Preise** trotz echtem „Made in Germany“
- **High-Tech Qualitätskontrollen**
wie z.B. inhouse Bondfähigkeitsprüfung, 3D-Oberflächeninspektion



3D-Oberflächenscan



3D-Scan Darstellung



Inhouse Bondtester



NESPER

Fortschritt formen.

ÜBER NESPER

NESPER wurde 1956 gegründet und befindet sich bis heute zu 100 % in Familienbesitz.

Ein Garant für Beständigkeit, Zuverlässigkeit und langfristige Zusammenarbeit.

Seit sieben Jahrzehnten entwickeln und fertigen wir hochpräzise, zuverlässige und wirtschaftliche Komponenten für anspruchsvolle Industrien. Dieses umfassende Know-how macht uns zum starken Partner für Ihre zukünftigen Projekte.

Unser Hauptsitz befindet sich in Ispringen bei Pforzheim. Zusätzlich betreiben wir einen weiteren Standort mit eigener Produktion in **LaGrange, Georgia (USA)**, um unsere Kunden weltweit optimal zu unterstützen.

DEUTSCHLAND

Egon Nesper GmbH & Co. KG

Industriestraße 16-20

D-75228 Ispringen

Tel.: +49 7231 88670-0

info@nesper.com

USA

Nesper International, Inc.

107 Wiley Road

LaGrange, GA 30240

Tel.: +1 (706) 812 1966

Fax: +1 (706) 812 1972

usa@nesper.com

[NESPER.COM](https://www.nesper.com)

